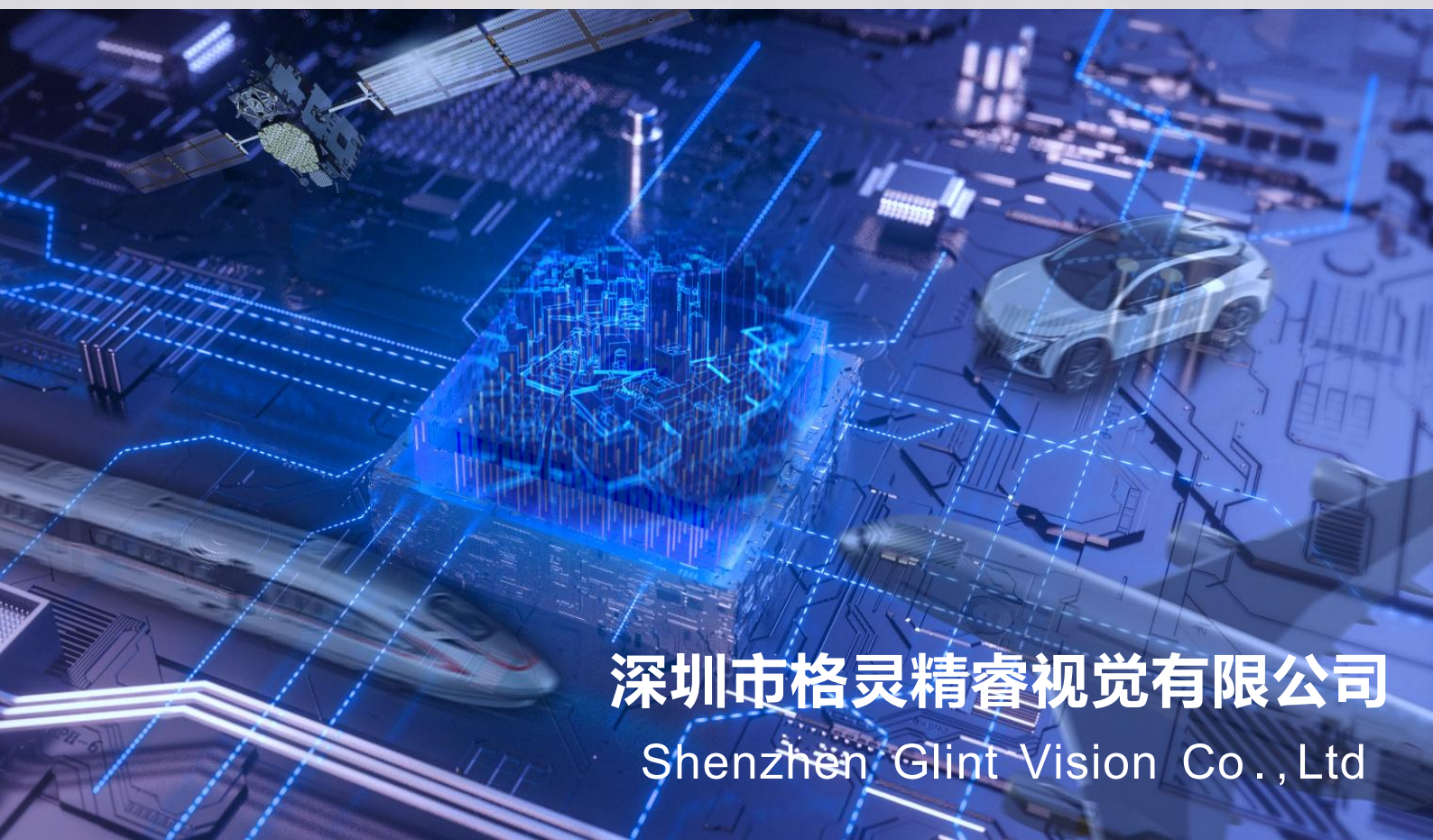




产品手册

2023



深圳市格灵精睿视觉有限公司

Shenzhen Glint Vision Co., Ltd

深圳市格灵精睿视觉有限公司 Shenzhen Glint Vision Co., Ltd



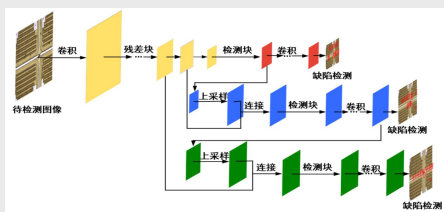
深圳市格灵精睿视觉有限公司是国内唯一一家同时拥有“3D视觉传感器、测量软件平台、工业视觉高端检测装备”的企业，全面掌握工业视觉“精密测量+AI缺陷检测”核心算法与技术。作为一家创新型企业，2021年被中国（深圳）天使投资峰会评估为最具估值成长性企业（TOP20）；2022年通过国高认证；未来3年内，公司将立志成为国内顶尖的视觉检测高端装备企业。

公司拥有高水平的技术团队、航天级系统工程制造经验、完备的产品质量体系；同时建有国内一流的视觉验证平台、半导体万级洁净车间、大型装备组装仓储中心。公司研制3D视觉传感器和高端成套检测装备，已成功应用在半导体、新能源、轨道交通等行业头部企业，实现AI赋能制造业这一企业愿景。

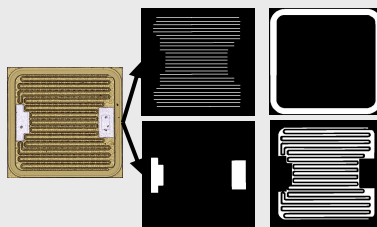
格灵精睿人工智能技术应用于半导体缺陷检测领域的先行者

核心技术：深度学习与多种显微成像模式结合快速、精准检出与分类不同种类缺陷。

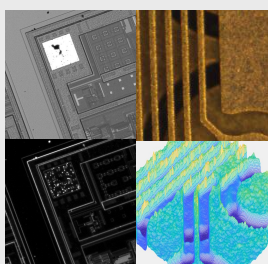
深度学习缺陷识别分类技术



图像处理技术

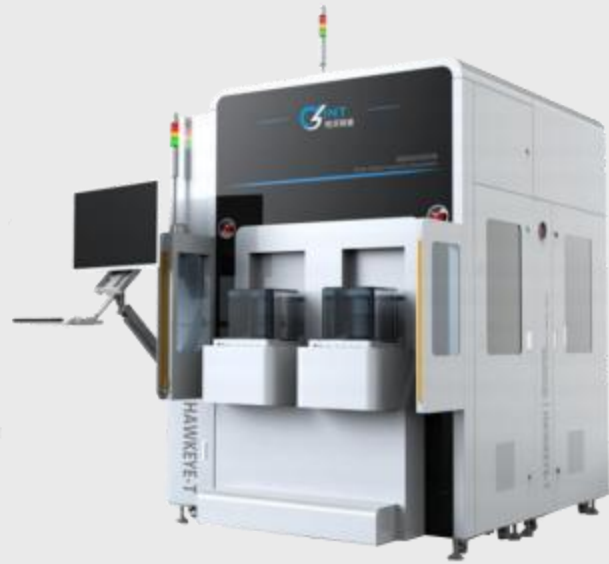


显微成像技术



机械运动控制技术





Hawkeye-S

1.功能概述

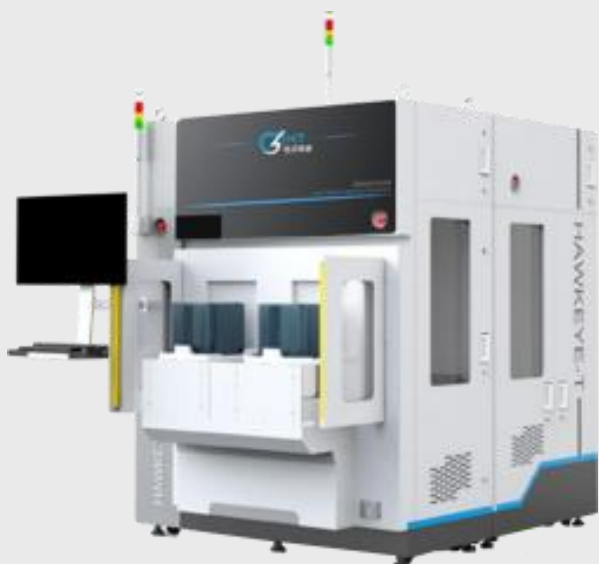
用于前道晶圆制造过程中的质量监控。可检测光刻后有图形晶圆后续加工步骤可能产生的损伤、异物、图形缺陷。

2.产品优势

- 1) 检测精度在国内处于领先地位;
- 2) 检测效率高于国内同类产品, 对标国际标准;
- 3) ADC智能缺陷分类识别功能, 降低人工复检工作量;
- 4) 为客户建立缺陷大数据集, 实现对工艺的智能管控;
- 5) 按客户需求进行软件及部分硬件的定制化。
- 6) 配件全国产化, 实现国产替代, 避免因技术封锁带来的损失。

3.技术参数

项目	规格参数
晶圆尺寸	6、8、12英寸
晶圆厚度	150~1500um
检测方式	灰度检测 / 彩色复检
成像方式	明场/暗场/紫光/红外
物镜倍率	2x、5x、x10、x20、x40、x100
分辨率	>0.19 um
ADC智能缺陷分类识别功能	支持



Hawkeye-T

1.功能概述

用于后道晶圆封测过程中的质量监控。可检测封测来料损伤、异物、图形缺陷，及划片后Frame晶圆，可能出现的损伤（崩边、裂纹/隐裂、针痕）、异物、bumping缺陷。

2.产品优势

- 1) 检测效率高于国内同类产品，对标国际标准；
- 2) ADC智能缺陷分类识别功能，降低人工复检工作量；
- 3) 为客户建立缺陷大数据集，实现对工艺的智能管控；
- 4) 按客户需求进行软件及部分硬件的定制化。
- 5) 配件全国产化，实现国产替代，避免因技术封锁带来的损失。

3.技术参数

项目	规格参数
晶圆尺寸	6、8、12英寸（Frame）
晶圆厚度	150~1500um
检测方式	灰度检测/彩色复检
成像方式	明场/暗场/红外
物镜倍率	2x、5x、x10
分辨率	>0.9 um
ADC智能缺陷分类识别功能	支持



Hawkeye-P

1.功能概述

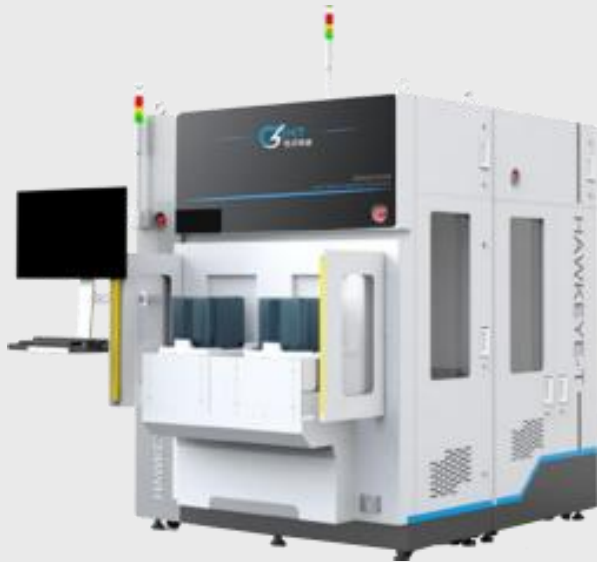
用于后道晶圆封测过程中的质量监控。可检测封测来料损伤、异物、图形缺陷，及划片后Frame晶圆，可能出现的损伤（崩边、裂纹/隐裂、针痕）、异物、bumping缺陷。

2.产品优势

- 1) 检测效率高于国内同类产品，对标国际标准；
- 2) ADC智能缺陷分类识别功能，降低人工复检工作量；
- 3) 2D与3D结合，可实现bump形貌测量；
- 4) 为客户建立缺陷大数据集，实现对工艺的智能管控；
- 5) 按客户需求进行软件及部分硬件的定制化。
- 6) 配件全国产化，实现国产替代，避免因技术封锁带来的损失。

3.技术参数

项目	规格参数
晶圆尺寸	6、8、12英寸（Frame）
晶圆厚度	150~1500um
检测方式	灰度检测/彩色复检
成像方式	明场/暗场/红外/共聚焦
物镜倍率	2x、5x、x10、x20
横向/轴向分辨率	>0.42 um / >0.1 um
ADC智能缺陷分类识别功能	支持



Hawkeye-SiC

1.功能概述

用于第三代半导体（SiC、GaN）晶圆制造过程中的质量监控。可检测加工工艺缺陷（划伤、崩边、裂纹等）和晶体结构缺陷（多晶、多型、微管、空洞、包裹物、应力等）。

2.产品优势

- 1) 检测效率高;
- 2) ADC智能缺陷分类识别功能，降低人工复检工作量;
- 3) 为客户建立缺陷大数据集，实现对工艺的智能管控;
- 4) 独家产品，可按客户需求进行软件及部分硬件的定制化。
- 5) 配件全国产化，避免因技术封锁带来的损失。

3.技术参数

项目	规格参数
晶圆尺寸	4、6、8英寸
晶圆厚度	150~1500um
检测方式	彩色检测
成像方式	暗场/透射偏振/宏观
物镜倍率	1x、2x
分辨率	>4um
ADC智能缺陷分类识别功能	支持



AOI-X

1.功能概述

用于MEMS晶圆（DB图纸比对模式）、陶瓷基底微电路、微型PCB等特殊产品缺陷检测。

2.产品优势

- 1) 多种倍率组合的透射、反射式显微系统；
- 2) 精度国内领先；
- 3) 大尺寸样品检测；
- 4) 按客户需求进行软件及硬件的定制化。
- 5) ADC智能缺陷分类识别功能，降低人工复检工作量。

3.技术参数

项目	规格参数
样品尺寸	最大400 x 400
样品厚度	无限制
检测方式	彩色检测
成像方式	透射、反射
物镜倍率	0.06x~20x
分辨率	>0.5 um
ADC智能缺陷分类识别功能	支持

邮箱: sales@szgint.com

公司座机: 0755-86576880-8333

华南区域: 18307551688 (宫先生)

华东区域: 15068862999 (许先生)

地址: 广东省深圳市南山区粤海街道高新南环路46号

留学生创业大厦二期二楼



公众号



公司官网



视频号